

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 1 月 16 日收到上海证券交易所出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 2 次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于 2026 年 1 月 10 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿)》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司于 2026 年 1 月 27 日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。相较草案（上会稿），草案（注册稿）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易已履行的程序、业绩承诺与补偿安排、标的公司财务报告截止日后经营情况
重大风险提示	更新本次交易审批风险、标的公司未能实现业绩承诺及补偿覆盖比例较低的风险
第一章 本次交易概况	更新本次交易已履行的程序
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司历史沿革
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方存续期与锁定期匹配情况
第六章 标的资产评估情况	更新定价公允性分析等
第七章 本次交易主要合同	新增《业绩补偿协议之补充协议》

章节	修订情况
第九章 管理层讨论与分析	更新标的公司财务报告截止日后经营情况
第十二章 风险因素分析	更新本次交易审批风险、标的公司未能实现业绩承诺及补偿覆盖比例较低的风险

此外，根据公司签署的《业绩补偿协议之补充协议》，调整了全文相关表述，详见《草案（注册稿）》楷体加粗部分内容。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 27 日